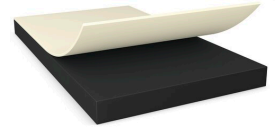




# 58452

## 제품 정보



50µm EC HAF 블랙 전기 전도성 (XYZ) 반응성 열압착 필름 테이프

## 제품 설명

tesa HAF® 58452 전기 전도성을 갖는 페놀 수지 및 니트릴 고무 기반의 경화성 열압착 필름입니다. 이 블랙 양면 테이프는 백킹이 없고(무기재), 50 µm PET 라이너로 보호됩니다.

상온에서 tesa HAF® 58452 끈적거리지 않습니다. 조립 과정에서 가해지는 열과 압력에 의해 활성화된다

### 특성:

- Extremely high performance, even on small bonding areas and thin design gaps
- Excellent electrical conductivity in XYZ-direction
- Superior anti-repulsion properties even at elevated temperatures
- Outstanding chemical resistance

## Applications

tesa HAF® 58452는 다양한 금속 재료의 접착에 권장된다, 예) SUS 또는 AL.

- Grounding applications with structural bonding requirements
- Narrow and small bonding areas but still need very strong bonding strength
- High repulsion force applications such as curved or bended bonds
- Grounding applications exposed to high temperature and humidity

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### 제품 구조

• 기재 소재	없음	• 총두께	50 µm
• 접착제 종류	니트릴고무 / 페놀수지	• 컬러	검정
• 이형지 종류	PET		

### 속성 / 성능 값

• z-축 방향 접촉저항 (2kg)	50 mOhm	• 표면 저항 x-y-축 방향	500 mOhm
• 접착력 (동적 전단)	7 N/mm <sup>2</sup>		

### 추가정보

Technical recommendations: tesa HAF® 58452 is not self adhesive. It is activated by heat and pressure over a certain interval. The following values are recommendations for bond line parameters to start with.

관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=58452>



# 58452

## 제품 정보

### 추가정보

1. Pre-lamination: During pre-lamination, the tape is laminated onto one component.

Setting:

- Temperature<sup>1</sup> ≥120 °C
- Pressure<sup>2</sup> ≥5 bar
- Time ≥5 s

2. Bonding: Remove the liner from the tape after pre-lamination step. Place the pre-laminated component onto the substrate to bond with. Apply sufficient temperature while applying pressure for the bonding time to reach sufficient bonding strength.

Setting:

- Temperature<sup>1</sup> 120-250 °C
- Pressure<sup>2</sup> 5-30 bar
- Time 5 s – 3 min

<sup>1</sup> 'Pre-lamination' and 'Bonding' temperature refer to the data that is measured in the bond line. <sup>2</sup> 'Pre-lamination' and 'Bonding' pressure refer to the force that is transformed from jig surface directly to the bonding area. Bonding strength values were obtained under standard laboratory conditions. (Material: SUS test specimen / bonding conditions: temperature = 180 °C; pressure = 30 bar; time = 30 sec). To reach maximum bonding strength surfaces should be clean and dry.

## 공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=58452>